#### **PATENT**



#### **DOCKET NO. C2405**

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Kajiura et al.

Art Unit:

2833

Serial No:

09/638,119

Examiner:

(Not Yet Assigned)

Filed:

14 August 2000

For:

**Electrical Connector with** 

**Thermal Sensor** 

October 12, 2000

### **Box Missing Parts**

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

# SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT AND CLAIM FOR FOREIGN PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119 AND 37 C.F.R. § 1.55

Applicants provide a certified copy of the foreign application referenced in the

Declaration. Applicants claim priority to the foreign application.

Respectfully submitted

Brian J. Hamilla

Attorney for Applicants Registration No. 38,482

Attorney Docket No. **C2405** 

FCI USA, Inc. Intellectual Property Law Department 825 Old Trail Road Etters, PA 17319 Telephone (717) 938-7839

> I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to: Box Missing Parts Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231 on <u>October 12, 2000</u>

Diane H. Brougher

Date of Signature

A:\C2405 Priority Document



# 日本国特

C2909

us cose

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 8月13日

出 顯 番 号 Application Number:

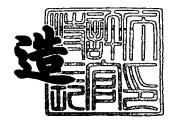
平成11年特許願第229472号

エフシーアイジャパン株式会社

2000年 7月28日

特許庁長官 Commissi ner, Patent Office





#### 特平11-229472

【書類名】 特許顯

【整理番号】 F06484A1

【提出日】 平成11年 8月13日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01R 23/68

G01K 1/14

G01K 1/16

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区南大井三丁目28番10号 エフシーアイ

ジャパン株式会社内

【氏名】 梶浦 索

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区南大井三丁目28番10号 エフシーアイ

ジャパン株式会社内

【氏名】 高橋 諒祐

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区南大井三丁目28番10号 エフシーアイ

ジャパン株式会社内

【氏名】 增田 浩

【特許出願人】

【識別番号】 391011386

【氏名又は名称】 エフシーアイジャパン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】 要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 カードコネクタ

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 PCカードを抜き差し自在に支持し、上記PCカードと電子機器とを電気的に接続するカードコネクタであって、支持されたPCカードの表面温度を検知する検知手段と、得られた温度情報を上記電子機器に送信する送信手段とを備えることを特徴とするカードコネクタ。

【請求項2】 上記PCカードと上記電子機器とが、上記カードコネクタに支持されたトランジションボードを介して電気的に接続され、上記送信手段が、上記温度情報を、上記トランジションボードを介して上記電子機器に送信することを特徴とする請求項1に記載のカードコネクタ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、PCカードを抜き差し自在に支持し、PCカードと電子機器とを電 気的に接続するカードコネクタに関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

コンピュータ等の電子機器の小型化に伴い、電子機器にカードコネクタを設け、このカードコネクタを介して、各種の機能を有するPCカードを接続し、電子機器の機能を拡張することが行われている。

[0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、PCカードは使用時に発熱するため、カードコネクタに支持されて使用中、PCカード自身や電子機器が、発熱による悪影響を受ける可能性があった。本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、PCカードの発熱による上記悪影響が防止可能なカードコネクタの提供を目的としている。

[0004]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明は、PCカードを抜き差し自在に支持し、上記PCカードと電子機器と を電気的に接続するカードコネクタであって、特に、支持されたPCカードの表 面温度を検知する検知手段と、得られた温度情報を上記電子機器に送信する送信 手段とを備えることを特徴としている。

[0005]

この場合、上記送信手段が、上記温度情報を、上記カードコネクタに支持されて上記PCカードと上記電子機器とを電気的な接続するトランジションボードを介して、上記電子機器に送信することが望ましい。

[0006]

#### 【発明の実施の形態】

以下、図面に基づき、本発明の実施形態について説明する。

本発明に係るカードコネクタの構造の例を図1ないし図3とともに説明する。 カードコネクタ1は、コネクタ本体2と、コネクタ本体2の一端(図1中左端) 側に形成された接続部3と、コネクタ本体2の一方の側面上に形成されたエジェ クト機構4と、コネクタ本体2を上下から覆うカバー5と、カバー5に設置され た温度センサ(検知手段)6とから概略構成されている。

[0007]

コネクタ本体2は、左右一対の平行な腕部2a,2bと、腕部2a,2bの一端同士を連結する基部2cとからなる樹脂製の部材で、図1に示すように、上方視して他端に向け開口するコ字状をなしている。また、腕部2a,2b間には、PCカードC挿入用の空間21が形成され、腕部2a,2bの、空間21を挟んで対向する側面には、腕部2a,2bの長手方向に延びる上下2本の溝部(図示せず。)がそれぞれ形成されている。そして、これら溝部に案内されて、上下2枚のPCカードCが、図1に矢印Sで示すように、他端側から空間21内に挿入可能となっている。

[0008]

接続部3は、基部2b上に、基部2cの長手方向に沿って配列された複数のピン(図示せず。)と、これらのピンを上下から覆うカードバスシールド31と、

上記ピン及びカードバスシールド31が接続されたトランジションボード(以下、ボードと略称する。)33とを備えている。

#### [0009]

上記ピンには、空間21内に挿入された上下2枚のPCカードCが、それぞれ独立して接続可能とされている。また、カードバスシールド31は、空間21内に挿入されたPCカードCの表面と接触し、接地電極として作用するとともに、PCカードCの内外を電磁シールドする。一方、ボード33は、基部2cに沿って立設された小型のプリント配線基板で、その側面には、後述する図7に符号33aで示すように、複数の孔が形成されている。これらの孔33aには、上記ピン及びカードバスシールド31から延びる端子(図1に符号32で示す部材)が挿入され、ハンダ付け等の方法で固定されている。

#### [0010]

また、ボード33の下端には、電子機器(図示せず。)との接続に使用される 複数の接点が、図7に符号33bで示すように、ボード33の長手方向に沿って 形成されている。これらの接点33bは個々の孔33aにそれぞれ連結され、そ の結果、カードコネクタ1に支持されたPCカードCが、これらの接点33bを 介して、電子機器に接続される。

#### [0011]

エジェクト機構4は、カードコネクタ1に対しPCカードCを着脱させるもので、PCカードCの着脱機構(図示せず。)と、コネクタ本体2の一方の腕部2 a上に、腕部2aに沿って移動可能とされ、バネ41によってコネクタ本体2の他端側に付勢されたエジェクト板42と、エジェクト板42の他端側に形成された操作ボタン43とを備えている。また、本実施例の場合、コネクタ本体2には上下2枚のPCカードCが挿入されるため、エジェクト機構4も、同一構成のものが上下に重ねて2基設けられている。

#### [0012]

カバー5は、空間21を上下から覆うよう腕部2a,2bにそれぞれ支持された板状をなす上下一対の部材で、その中央部に形成された支持部5aには、温度センサ6が、フレキシブルケーブル(送信手段、以下、ケーブルと略称する。)

7を介して設置されている。また、ケーブル7内には、温度センサ6に接続される配線71が、その長手方向に沿って埋設されている。

[0013]

支持部5 a 及び温度センサ6の具体的構造及び支持部5 a への温度センサ6の 設置状況の例を図4ないし図6とともに説明する。支持部5 a は、カバー5の中 央部を、エジェクト機構4の形成側と反対側の腕部2 b に向け開口するコ字状に 打ち抜き、形成された舌片状の部材を、空間21から離間する方向に持ち上げた ものである。また、支持部5 a の中央部には、温度センサ6より若干大型の孔H 」が形成されている。

[0014]

温度センサ6は、ケーブル7の一端に、空間21側に突出するよう設置されている。ここで、温度センサ6に接続される配線71の本数は、温度センサ6の仕様によって異なる。本実施形態の場合、温度センサ6には、Telcom Semiconductor社製のTC74型センサが用いられ、その結果、温度センサ6には、信号伝達用の3本の配線71aと、接地用の2本の配線71bとからなる5本の配線71が接続されている。また、ケーブル7の一端部には、空間21から離間する方向に屈曲する段部7aが形成され、ケーブル7の一端は、この段部7aにより、空間21から後退している。

[0015]

支持部5aへの温度センサ6の設置に際しては、温度センサ6を、図5に示すように、支持部5aの突出側から孔H<sub>1</sub>内に挿入後、図6に示すように、ケーブル7を、カバー5及び支持部5aの表面に支持させる。ここで、空間21に対する、支持部5a及びケーブル7の一端の後退量は、温度センサ6を支持部5aに設置した際に、ケーブル7の側面がカバー5及び支持部5aの表面と当接するとともに、温度センサ6が、空間21内に挿入されたPCカードCと干渉しない程度にカバー5から空間21側に突出するよう調節する。また、カバー5及び支持部5aへのケーブル7の支持に際しては、例えば接着等の方法を使用する。

[0016]

ケーブル7は、エジェクト機構4との干渉を避けるため、図1に示すように、

エジェクト機構4の形成側と反対側の腕部2bに向け延設された後、図3に示すように、この腕部2bの長手方向に沿って、コネクタ本体2の一端側に延設されている。本実施形態の場合、温度センサ6は、空間21を上下から覆うカバー5にそれぞれ設置されているので、腕部2b上には、個々のセンサ6から延びる2本のケーブル7が、図3に点線で示すように上下に重ねられている。また、符号8は、上下に重ねられた2本のケーブル7を腕部2b上に固定するためのテープである。

[0017]

ケーブル7の他端はボード33上に延び、ボード33に接続されている。ボード33へのケーブル7の接続状況の例を図7ないし図10とともに説明する。ボード33には、符号33aで示す孔に加え、図7に示すように、ケーブル7内に埋設された配線71を接続するための複数の孔33c,33dが形成され、これらの孔33c,33dは、符号33aで示す孔と同様、接点33bにそれぞれ連結されている。本実施例の場合、個々のケーブル7に埋設された配線71の数が5本であるため、孔33c,33dの数はいずれも5本となる。

[0018]

一方、ケーブル7の他端からは配線71が露出し、これら配線71の先端には、端子72がそれぞれ接続されている。そして、これらの端子72を、図8及び図9に示すように、対応する孔33c,33d内にそれぞれ挿入し、ハンダ付け等の方法で固定することにより、ケーブル7がボード33に接続される。本実施例の場合、上記の通りケーブル7が2本あるため、図10に示す通り、ケーブル7を上下に重ねたまま、それぞれの配線71から延びる端子72を、対応する孔33c,33d内にそれぞれ挿入する。

[0019]

また、符号9は、カードコネクタ1の隅部に形成された脚部で、カードコネクタ1は、これら脚部9を介して、ネジ止め等の方法で、電子機器に設置されている。

[0020]

カードコネクタ1にPCカードCを支持させる場合には、PCカードCを、カ

ードコネクタ1の他端側から空間21内に挿入する。すると、PCカードCの先端に形成された孔(図示せず。)内に、接続部3のピンがそれぞれ挿入され、これらのピンが、PCカードCに接続されるとともに、カードバスシールド31が、PCカードCの表面と接触し、その結果、PCカードCが、上記ピン及びカードバスシールド31から延びる端子32、ボード33の孔33a及び接点33bを介して、電子機器に接続される。

#### [0021]

また、空間21内にPCカードCが挿入されると、PCカードCが、上記着脱機構により空間21内に保持され、PCカードCがカードコネクタ1に支持される。更に、カードコネクタ1へのPCカードCの支持に伴い、エジェクト板42が、バネ41によってコネクタ本体2の他端側に押圧され、その結果、操作ボタン43が、図1ないし図3に符号Uで示すように、カードコネクタ1の他端から突出する。

#### [0022]

一方、カードコネクタ1に支持されたPCカードCの表面温度は、温度センサ 6により検知される。本実施形態の場合、カードコネクタ1には上下2枚のPC カードCが支持可能であるが、上方に位置するPCカードCの表面温度は上側の カバー5に設置された温度センサ 6により、下方に位置するPCカードCの表面温度は下側のカバー5に設置された温度センサ 6により、それぞれ検知される。温度センサ 6による検知結果(温度情報)は、ケーブル7内に埋設された配線71a、端子72、ボード33の孔33c,33d、及び接点33bを介して、電子機器に送信される。電子機器では、温度センサ 6 から送信された検知結果を常時監視し、PCカードCの表面温度が予め設定された温度より高温となった場合には、PCカードCへの通電を停止する等、所定の操作を行う。

#### [0023]

カードコネクタ1からPCカードCを引き抜く場合には、操作ボタン43を、 カードコネクタ1側に押し込む。すると、エジェクト板42が、バネ41に抗し てコネクタ本体2の一端側に移動した状態で係止され、操作ボタン43が、図1 ないし図3に実線で示すように、カードコネクタ1内に押し込まれるとともに、 空間21内に保持されていたPCカードCが、着脱機構によりコネクタ本体2の 一端側から押圧され、カードコネクタ1の他端側から突出する。

#### [0024]

上記構成を有するカードコネクタ1によれば、カードコネクタ1に支持された PCカードCの表面温度を温度センサ6により検知し、検知結果を電子機器にて 監視している。従って、PCカードCの発熱によりPCカードC自身や電子機器 が悪影響を受ける前にPCカードCの発熱を停止させることが可能となり、上記 悪影響が防止される。

#### [0025]

また、温度センサ6から延びるケーブル7がボード33に接続されているため、接点33bを介してボード33を電子機器に接続するだけで、温度センサ6と電子機器との接続が完了する。すなわち、上記構成を有するカードコネクタ1によれば、温度センサ6を、ボード33を介して電子機器に容易に接続することができる。

#### [0026]

なお、カードコネクタ1への温度センサ6の設置方法は、上記図4ないし図6に限定されるものではなく、例えば図11ないし図13に示すような種々の変形が可能である。図11ないし図13に示す例では、カバー5の中央部に、図11に示すような、温度センサ6より若干大型の孔H2を形成し、この孔H2内に、温度センサ6を、図12に示すように、空間21と反対の側(図中上方)から挿入する。この場合、カバー5には、上記図4ないし図6に示すような支持部5 aが形成されていないため、ケーブル7のうち段部7 cより一端側(空間21に対し後退する部分)に、段部7 cの同一高さのスペーサ10を、温度センサ6を前後から挟むように設置する。

#### [0027]

そして、図13に示すように、ケーブル7及びスペーサ10を、カバー5の表面に支持させることにより、温度センサ6が、空間21内に挿入されたPCカードCと干渉しない程度にカバー5から空間21側に突出するよう、カバー5に設置される。カバー5が存在しない場合には、空間21上に何らかの支持体を配設

し、この支持体上に、空間21に向け温度センサ6を設置してもよい。カードコネクタ1に支持されるPCカードCの数も、上下2枚のみならず、1枚、あるいは3枚以上であってもよい。更に、本発明の技術は、いわゆるカードバスタイプと呼称されるカードコネクタのみならず、カードバスシールドのないカードコネクタに対しても適用可能であることは言うまでもない。

[0028]

また、温度センサ6には、熱電温度計、抵抗温度計、放射温度計等、検知結果 を電気信号として送信可能な温度計であれば、あらゆる公知の温度計が使用可能 である。

[0029]

#### 【発明の効果】

以上説明した通り、本発明のカードコネクタによれば、カードコネクタに支持されたPCカードの表面温度を検知手段により検知し、得られた温度情報を電子機器にて監視しているため、PCカードの発熱によりPCカード自身や電子機器が悪影響を受ける前に、PCカードの発熱を停止させることが可能となり、上記悪影響が防止される。

[0030]

また、検知手段からの温度情報を電子機器に送信する送信手段が、上記温度情報を、カードコネクタのトランジションボードを介して電子機器に送信する構成とした場合には、トランジションボードを電子機器に接続するだけで検知手段と電子機器との接続が完了するため、検知手段と電子機器とを容易に接続可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明に係るカードコネクタの構造の例を示す図3中矢印Iに沿った上面図である。
- 【図2】 本発明に係るカードコネクタの構造の例を示す図1中矢印IIに 沿った側面図である。
- 【図3】 本発明に係るカードコネクタの構造の例を示す図1中矢印III に沿った側面図である。

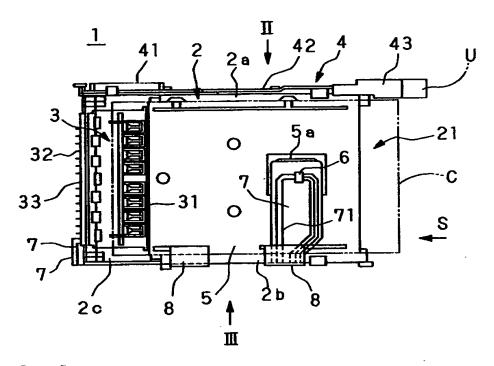
- 【図4】 本発明に係るカードコネクタにおける、支持部及び温度センサの 具体的構造の例を示す上方斜視図である。
- 【図 5】 本発明に係るカードコネクタにおける、支持部への温度センサの 設置状況の例を示す側面図である。
- 【図 6 】 本発明に係るカードコネクタにおける、支持部への温度センサの 設置状況の例を示す一部断面図である。
- 【図7】 本発明に係るカードコネクタにおける、フレキシブルケーブルと トランジションボードとの接続の例を示す図である。
- 【図8】 本発明に係るカードコネクタにおける、フレキシブルケーブルと トランジションボードとの接続の例を示す図である。
- 【図9】 本発明に係るカードコネクタにおける、フレキシブルケーブルとトランジションボードとの接続の例を示す、図8のIX-IX線に沿った断面図である。
- 【図10】 本発明に係るカードコネクタにおける、フレキシブルケーブルとトランジションボードとの接続の例を示す、図8の矢印Xに沿った側面図である。
- 【図11】 本発明に係るカードコネクタにおける、カバーに形成された温度センサ用の孔の例を示す上方斜視図である。
- 【図12】 本発明に係るカードコネクタにおける、支持部への温度センサの設置状況の例を示す一部断面図である。
- 【図13】 本発明に係るカードコネクタにおける、支持部への温度センサの設置状況の例を示す一部断面図である。

#### 【符号の説明】

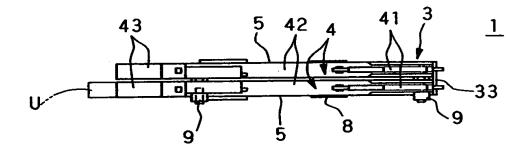
- 1 カードコネクタ
- 6 温度センサ(検知手段)
- 7 フレキシブルケーブル(送信手段)
- 33 トランジションボード
- C PCカード

# 【書類名】 図面

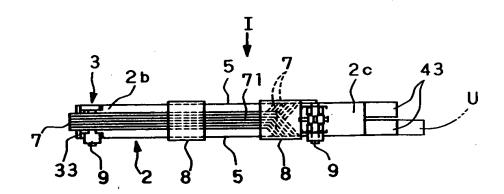
# 【図1】



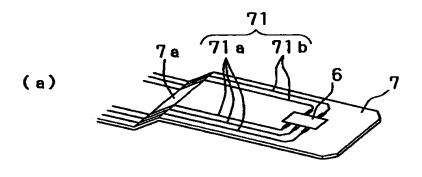
【図2】

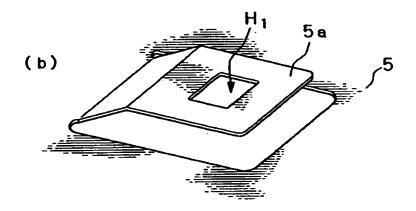


# 【図3】

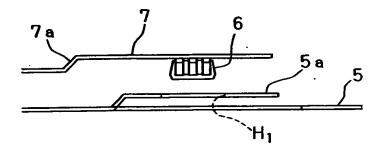


# 【図4】

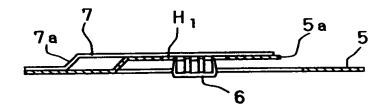




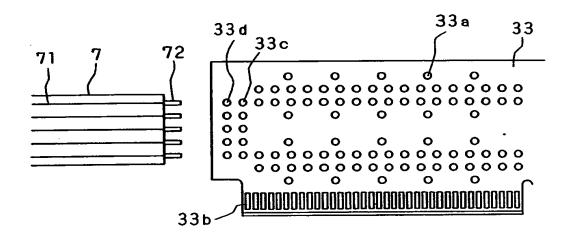
## 【図5】



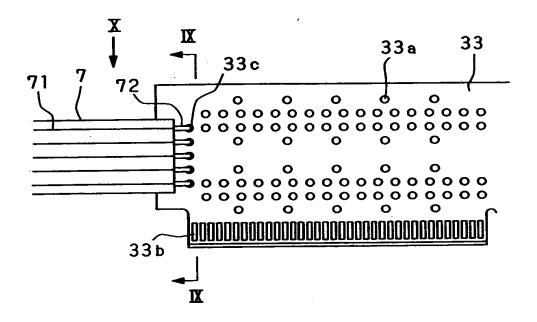
## 【図6】



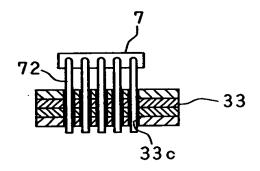
## 【図7】



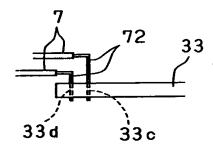
【図8】



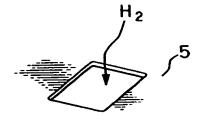
【図9】



【図10】

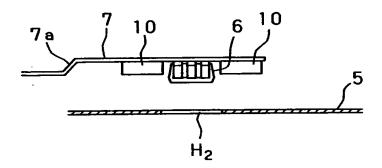


【図11】

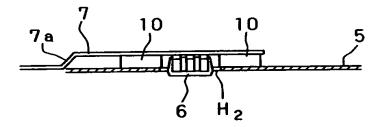




【図12】



【図13】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 PCカードを抜き差し自在に支持し、PCカードと電子機器とを電気的に接続するカードコネクタにおいて、PCカードの発熱による、PCカード自身や電子機器への悪影響を防止する。

【解決手段】 本発明は、PCカードCを抜き差し自在に支持し、PCカードC と電子機器とを電気的に接続するカードコネクタ1であって、特に、支持された PCカードCの表面温度を検知する検知手段6と、得られた温度情報を上記電子機器に送信する送信手段7とを備えることを特徴としている。この場合、送信手段7が、上記温度情報を、カードコネクタ1に支持されてPCカードCと上記電子機器とを電気的に接続するトランジションボード33を介して、上記電子機器に送信することが望ましい。

【選択図】

図 1

#### 認定・付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第229472号

受付番号 59900787092

書類名 特許顯

担当官 第四担当上席 0093

作成日 平成11年 8月17日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 391011386

【住所又は居所】 東京都品川区南大井三丁目28番10号

【氏名又は名称】 エフシーアイジャパン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100064908

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 鈴木 三義



## 出願人履歴情報

識別番号

(391011386)

1. 変更年月日 1999年 6月22日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都品川区南大井三丁目28番10号

氏 名

エフシーアイジャパン株式会社